

報道関係者各位

2015年11月4日
一般社団法人 組込みシステム技術協会
株式会社ICSコンベンションデザイン

組込み総合技術展 / IoT 総合技術展
「つながる」をテーマにした EDA-LPB パビリオンを新設
主要ベンダによる技術展示と専門セミナーで、EDA 最新情報を発信

一般社団法人 組込みシステム技術協会 (JASA)主催、「Embedded Technology 2015 (通称: ET2015)」「IoT Technology 2015」(会期:11月18日~20日、会場:パシフィコ横浜)では、本格的なIoT時代を迎え、半導体・基板設計に重要度が高まる EDA 技術にフォーカスした EDA-LPB (Electronic Design Automation-LSI Package Board) パビリオンを新設いたします。

IoT 環境下において、つながるモノは半導体なしではインターネット化ができません。その半導体は、製造工程の自動化を支援する EDA 技術を抜きにしては開発できないのが現状です。

EDA-LPB パビリオンは昨年の EDA ゾーンをさらに発展させ、半導体やプリント基板、電子部品の設計・製造に関わる多彩なEDAツールと、今年 IEEE2401 として標準化された LSI-Package-Board 相互設計ワーキンググループ、ジェム・デザイン・テクノロジーズ、CM エンジニアリング、図研、TOOL、日本ケイデンス・デザイン・システムズ、日本サーチット、Future Facilities、プロトタイピング・ジャパン、メンター・グラフィックス・ジャパン、WADOW(※50 音順)

EDA-LPB パビリオン出展社

アストロン、アンシス・ジャパン、インターバディ、ATE サービス、NTT データ数理システム、オーバートーン、JEITA EDA 技術専門委員会 LSI-Package-Board 相互設計ワーキンググループ、ジェム・デザイン・テクノロジーズ、CM エンジニアリング、図研、TOOL、日本ケイデンス・デザイン・システムズ、日本サーチット、Future Facilities、プロトタイピング・ジャパン、メンター・グラフィックス・ジャパン、WADOW(※50 音順)



**■ET2015 公式ウェブサイトにて各社の見どころや出展製品・サービスを公開中
新製品 Pick Up !**

・アストロン CAD ナビゲーションシステム「AZSA」

設計データ(GDS II)と故障解析装置(エミッション顕微鏡)、電子顕微鏡(SEM、FIB、プローバー)のリンクエージがとれる最新版のシステム。周辺ツールとして CAD や電子顕微鏡像からの 3 次元解析も可能。

・アンシス・ジャパン 電磁界、回路・システム解析ソフトウェア

エレクトロニクス製品設計における、シリアル伝送、パワー・インテグリティ、伝導ノイズ、ESD、エミッションとイミュニティなど、電子機器設計における様々な問題に対応するシミュレーション環境を初出展。他、モデルベース統合システム開発環境もあわせて展示！

・インターバディ SyDAP model

「SyDAP model (サイダップモデル) System Debug Assist Peripheral model」は、システムデバッグを支援する仮想検証向けのマイコン周辺モジュールの SystemC モデル群。SystemC/TLM2.0 に準拠した標準的なインターフェイスであり、既存の仮想検証環境にも容易に組み込むことが可能。かつ機能部は C 言語で実装することで高速動作を実現。

※ 最新の出展社情報はウェブサイトをご覧ください。

■ET2015 EDA-LPB パビリオン 特設ウェブサイトもオープン！

出展社情報やブース内のセミナースケジュールを公開中

>> <http://lpb.jpn.org/et2015/>

■ EDA-LPB 専門セミナー開催：SoCをテーマとした基調講演、IoTを見据えたパネルセッション

前回実施したEDA トラックを「EDA-LPB トラック」に改め、LPB フォーマットの動向も対象とした専門トラックとして実施。基調講演、パネルセッションに加え、7回目となるLPB フォーラムを実施します。

>> <http://www.jasa.or.jp/expo/conf/confpage-eda.html>

11/20(金)13:00～14:45 アネックスホール 2階 [F201]

第1部 <基調講演>

さらば SoC、されど SoC トランジスタから回路、回路から機能ブロック、
機能ブロックからシステム、システムから？

脇本 康裕 株式会社ソシオネクスト 第三事業本部 コネクテッドイメージング事業部 事業部長

第2部 <パネル討議>

IoT 時代における半導体と EDA の進むべき道 爆発的なビジネス拡大に備えよ、
その道で本当に大丈夫ですか！？

モデレーター：津田 建二 株式会社セミコンダクタポータル 編集長

11/20(金)15:00～16:45 アネックスホール 2階 [F201]

第7回 LPB フォーラム

第1部 LSI パッケージボード設計標準フォーマット IEEE2401-2015 制定発表

第2部 座談会 IEEE2401-2015 で広がる機器設計の情報流通

福場 義憲 一般社団法人 電子情報技術産業協会 半導体部会 EDA 技術専門委員会

LSI パッケージボード相互設計ワーキンググループ 主査

※ ご来場の際は、公式ウェブサイトにて、来場事前登録を行ってください。

----- 開催概要 -----

Embedded Technology 2015 / IoT Technology 2015 2015年11月18日(水)～20日(金)@パシフィコ横浜

主催：一般社団法人 組込みシステム技術協会 / 企画・推進：株式会社 ICS コンベンションデザイン

■ニュースリリースに関する報道関係者からの問い合わせ先

Embedded Technology プロモーション担当／株式会社ピーアンドピービューロウ

TEL.03-3261-8981 guidebook@et-guide.com [担当] 樋口

■本展に関する一般の方からの問い合わせ先

Embedded Technology 事務局(株式会社 ICS コンベンションデザイン) 内山/山口

TEL.03-3219-3648 etinfo@jasa.or.jp